供应HOTFLOW-9CR无铅微循环回流焊

产品名称	供应HOTFLOW-9CR无铅微循环回流焊
公司名称	深圳市智驰科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:HOTFLOW 型号:9CR 类型:二手
公司地址	深圳市宝安区福永镇塘尾华丰科技园11栋2、3楼
联系电话	0755-27456080 13560723306

产品详情

HOTFLOW-9CR无铅微循环回流焊详细配置

一、加热区

1、世界顶级的微循环加热方式

■采用世界顶级德国技术，世界范围内领先的微循环加热方式，收风口离吹风口最近，吹风加热PCB板时不受收风（已交换后的降温的风）影响，加热极为稳定。PCB板连续过板对炉体内PCB板的受热影响只有±1℃，其稳定性之高是无铅焊接严格制程的最佳选择；

■由于采用独特的微循环运风方式，消除了导轨对PCB板面受温不良的影响;

■由于采用独特的微循环运风方式,可大幅减小相领温区间的互相影响,特别适合于无铅焊接及多种高难焊接曲线的实现,对PCB板的加热比同类机更均匀，更迅速；

2、世界顶级的热交换技术

■采用密点阵，大风量，热交换技术，对PCB板的加热速度极快，炉体内空气温度可以以极快的方式传递到PCB板面上，炉温设置可比同类机型低15-20℃,环保省电;

■快速的热交换率,可使炉温设置与PCB板温之间的△t温度低至15℃以内,可大大减低热风对PCB板面及元器件的微损伤;

■快速的热交换率可使板面上大小元件的偏差迅速减小,电脑板板面与BGA底面的温差可低至5°-9℃之间;

3、标准化的炉膛制做

■采用与国际接轨的制做方法,引进全自动CNC钣金作业,加工误差0.10mm,全自动折弯机作业,多个温区加工模组化,标准化,各区的热风风力完全标准划一;

4、四个回流焊接区

■配置4个回流焊接区,根据产品及锡膏化锡曲线调节升温方式,可实现高难焊接曲线;

5、高温部件

■采用台湾耐高温马达,漆包线国内唯一采用H级(漆包线表面绝缘温度上限可高达220℃)长期使用,稳定可靠;

■螺旋形发热丝设计,热响应速度快,使用寿命长,控温精确;

6、热风风速可调设计

■八温区采用变频调节风速,可根据不同产品工艺(锡膏板或点胶板)设置不同风速(无级可调),有效避免元器件吹偏的情况;

7、启盖

■加热区上盖可自动打开,方便维护;

■并配有开盖安全装置;

8、发热丝外置式设计及运风马达外置式设计

■发热丝采用外置式设计,更换发热丝无须开启炉膛,维护方便;

■运风采用外置式设计,更换运风马达无须开启炉膛,维护方便;

二、冷却区

1、风刀式急冷技术

■采用日本ETC公司风刀式急冷技术,放大镜式集中高效急冷,风源从炉体外部采集,引入冷却区内;

■板面及板底同时急冷,冷却效率极高,冷却速度可达3.5-6℃/秒;

2、冷却系统

■配备急冷却系统,冷却降温快;

3、外置风扇冷却

■冷却区外再外置风扇冷却,进一步冷却以利于后段作业,出炉温度可达65℃以下;

4、松香回收系统

■正压式松香回收方式,上下设计回收废气槽,回收十分彻底,松香回收率可高达98%,冷却区内可保终身免维护,更不会发生松香滴到PCB板上造成污

染的状况;

■松香定向流至储存并瓶中,更换清理十分方便;

■采用不锈钢管传送废气,终身免维护;

三、传输系统

1、传输导轨

■高强度抗高温铝材传输导轨,选用配加铬锰合金.长期高温使用抗变形,强度高;

■外形采用BTU导轨外形,“ Ⅱ ”字型结构,尤其针对PCB宽度方向抗弯曲,抗变形;

2、传输链条

■采用高碳钢加长销链条,长期高温使用,抗高温变形,加长销长5mm,承托PCB板;

3、防调宽大小头机构

■国内首家采用五丝杆传动机构,整条导轨由五个丝杆分成四部分限位调宽,确保炉体加热区及冷却区段导轨长期使用不发生变形,避免PCB板发生掉板或夹板现象;

4、传输机械模组

■日本松下马达传动组件,电脑设定传输速度;

■并具有自诊断偏差报警功能;

5、电动调宽机械模组

■日本松下马达传动调宽,换线方便;

6、网带传送方式

■同时附有网带传送方式,与导轨传送方式同步传送,可根据生产需要选择过板方式;

■特别设计网带防走偏装置,可防止网带走偏现象;

7、UPS不间断供电

■停电可自动转为UPS供电,可将PCB板传送出炉膛,避免PCB板的热损坏;

■停电保持电脑供电,可及时退出电脑,防止电脑损坏;

四、控制系统

1、Windows操作界面

■Windows2000操作界面，操作简便，界面友好；

2、储存及设置工艺参数	■工艺参数，可随时设置、存储及调用,针对不同PCB板工艺参数的管理方便；
3、曲线测试	■系统具有6通道温度曲线测试功能方便准确判断各区状态，并可存储，调用及打印温度曲线；
4、曲线分析功能	■可分析最高温度，区间段时间升降温率，方便工艺调节；
5、密码管理	■系统拥有密码管理操作系统，防止无关人员改动参数；
6、页面锁止功能	■系统具有页面锁止功能，自动锁止页面，防止误操作；
7、操作记录管理	■系统可追溯工艺参数的改动过程方便改善管理；
8、自动加油功能	■电脑控制自动润滑系统,可通过电脑设置加油时间及加油量,自动润滑传输链条；
9、集成控制窗口	■电脑开关,电动调宽,测试曲线,打印曲线及传输数据,均可在集成窗口中操作,方便人性化；
10、控制系统	■全电脑控制方式；

五、外观

1、框架及外形	■采用框架设计,底部加厚型方钢框架,外壳分块安装,所有部件可互换,完全标准化,底部设有定位脚杯及移动脚轮；
2、机体内部	■底板采用孔板辅垫,外表美观并便于清洁；
3、表面处理	■本机采用全喷塑处理，表面强度高、易于清洁、表面美观；
4、液晶显示器	■采用15寸液显显示器，内藏式电脑设计，外观美观;
	■调节工艺参数方便；

HOTFLOW-9CR全电脑无铅微循环回流焊机技术参数:

适用锡膏类型	无铅焊料/普通焊料
加工最大基板尺寸(mm)	400(W)×450(L)
传输速度	0-1800mm/min
适用元件种类	CSP、BGA、μBGA、0201chip
机身尺寸L×W×H	5000×1350×1550mm
温区构成	加热区:上8区,下8区 16温控 4个专用冷却区
温度控制精度	±1°C
PCB横向温度偏差	±2°C
传送带宽度	480mm
传输方向	L→R （R→L选项）
传送方式	链条/网带
传送链条面高度	900±20mm
温度控制方式	各温区独立PID控温
温度控制范围	室温-350°C
升温时间（冷机启动）	25分钟以内
温度稳定时间	5分钟以内
起动功率/正常工作功率	53kw/10.5kw

控制系统	电脑控制
停电保护	UPS不间断电源
炉体开启	气动启盖
气源	5-7kg/cm2
电源	3 ø 380V
机体重量	1800kg